

『セラピール』について

<タイプ> 市場・用途に応じて剥離力の対応可能

◆軽剥離 (0.08~0.12N/50mm) : MF, MD, BK, WD, WZ

◆中剥離 (0.18~0.8N/50mm) : BX8, BX9, BX10

◆重剥離 (5.7N/50mm) : BL

◆非シリコーン (8.0N/50mm) : HP2

<設備> クリーンな環境での塗工が可能

◆コート幅 : ~1,600mm

◆フィルム厚み : 25~350 μ

◆防塵度 : ・超防塵 ヘッドclass100、ルームclass1,000

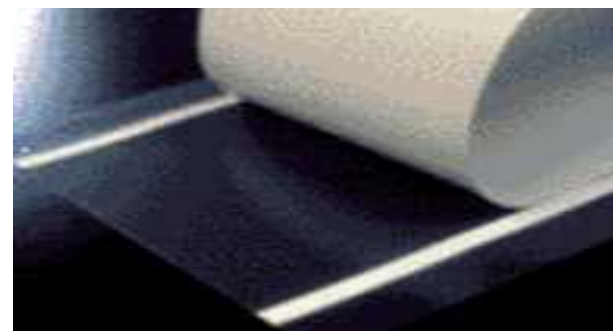
・防塵 ヘッドclass1,000、ルームclass10,000

<特徴>

◆基材PETの選択性 : 厚み、平面性、光学特性など用途に寄って適した基材PETと離型剤を選択

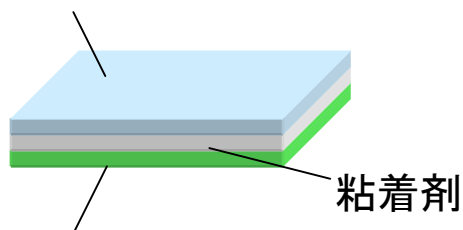
◆高密着 : 残留接着率95%以上

◆用途 : 光学粘着、MLCC等多岐に渡る用途でのご使用実績



『セラピール』ノンキャリア用途

セラピール 軽剥離



セラピール 重剥離

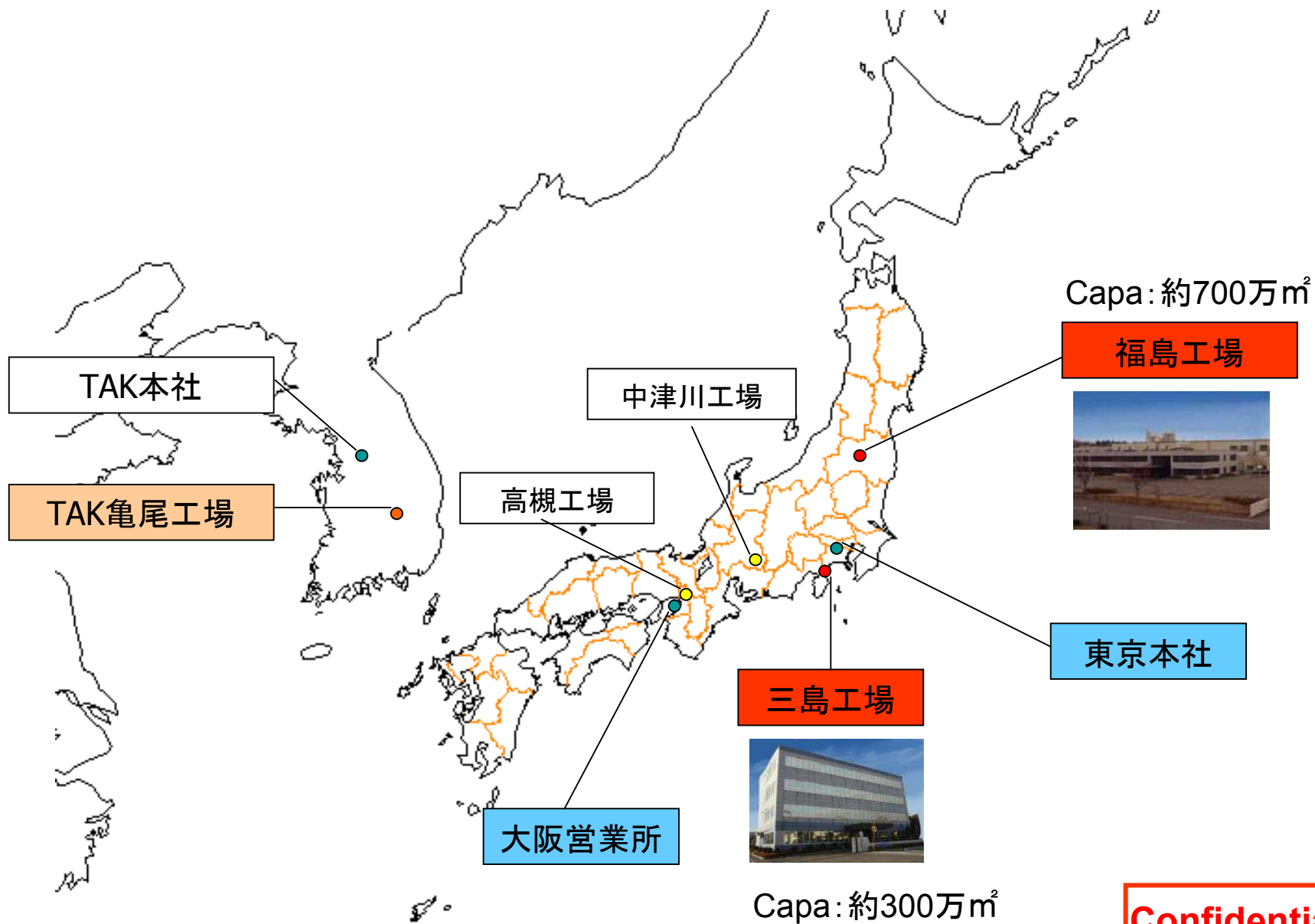
特長

- 離型層とPETとの密着性に優れ、**経時安定性良好**
(1年経過後も剥離特性維持)
- **番手・離型タイプ**組合せることでお客様のご要望に応える
(数量少ない場合には相談させていただきます)
- **帯電防止性能(約10乗)**を備えたタイプも開発中(SKG)

品番	タイプ	31B剥離力(常温×24h) mN/50mm 300mm/min剥離速度	残留接着率 %	密着性(ラフオフ性)	耐トルエン摩耗性
TK02	軽	60～70	90～95	シリコン脱落無し	○
WZ	軽	60～90	95以上	シリコン脱落無し	○
MFA	軽	60～90	95以上	シリコン脱落無し	◎
BKE	軽	60～90	95以上	シリコン脱落無し	◎
BX8A	重	150～180	95以上	シリコン脱落無し	◎
BX9A	重	240～280	95以上	シリコン脱落無し	◎

- * 粘着剤種類の違いで上記表中の剥離力とは異なる傾向を示す場合があります
- * 被着体(専用テープ等)をご提供頂ければご要望離型タイプ探索が早期実現可能です

『セラピール』製造&販売拠点



Confidential

『セラピール』タイプ別紹介

【セラピール一般物性表】

評価項目	試験条件	単位	軽剥離タイプ（一般）		軽剥離タイプ（高密度）			中剥離タイプ				重剥離タイプ	
			WZ	WD	MFA	BKE	MDA	BX8	試作typeA	BX9	試作typeB	BL	HP2
剥離強度	31Bテープ剥離（常温）	mN/50mm	80	80	80	80	90	175	200	275	500	1,300	6,000
	31Bテープ剥離（加熱）		130	130	80	90	80	250	300	400	測定中	-	11,000
残留接着率	常温	%	90以上	90以上	95以上	95以上	95以上	95以上	95以上	95以上	95以上	95以上	-
ラプオフ	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
背面移行	マジックインキ	-	○	△	○	△	○	○	○	○	○	○	○
耐溶剤磨耗性	トルエン	-	△	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MEK		-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	酢酸エチル		-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エタノール		-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考1	離型剤タイプ	-	Si系	Si系	Si系	Si系	Si系	Si系	Si系	Si系	Si系	Si系	非Si系
備考2	用途実績	-	・汎用粘着セパレーター		・光学粘着用セパレーター ・OCA用セパレーター（軽剥離側） ・セラミックコンデンサ製造工用 セパレーター			・光学粘着用セパレーター ・OCA用セパレーター（中剥離）				・医療用 セパレーター	・各種樹脂 成型用セパ レーター

【測定方法】

(1) 剥離力	日東電工(株)製の各種粘着テープ（50mm幅）を離型処理面に5kgのゴムローラーを用いて貼り合わせ、20℃/60%R.H.の雰囲気中24時間放置した後、引張試験機を用いて180°の方向へ300mm/分の速度で剥離し、剥離力を測定する。
(2) 残留接着率	①日東電工(株)製No.31Bテープを離型処理面に5kgのゴムローラーを用いて貼り合わせる。 ②所定の条件でエージングした後、テープを剥がし銅板テストパネルに①と同様にして貼合わせる。 ③引張試験機を用いて180°の方向へ300mm/分の速度で剥離し、剥離力を測定する。 ④一方、ブランクとしてフッ素系フィルムを用いて①～③と同様にして剥離力を測定する。 ⑤得られた剥離力から、右記式にて残留接着率を算出する。 ●エージング条件： （加熱）雰囲気70℃×20時間、荷重20g/cm ² （常温）雰囲気20℃×20時間、荷重20g/cm ² ●算出式： 残留接着率（%）＝（セラピールでの剥離力/フッ素フィルムでの剥離力）
(3) ラプオフ	離型処理面を指で5回擦り、その後のフィルムの状態を目視観察する。 ●判定基準：○変化無し、△スミア（白濁）、×離型層の脱落が確認できる
(4) 背面移行	非離型処理面にマジックインキで直線を描き、インキのハジキ度合いを目視にて評価する。 ●判定基準：○弾かない、△やや弾く、×かなり弾く
(5) 耐溶剤磨耗性	①学振型摩耗試験機を用い、離型処理面を各種溶剤約1ccを染み込ませた綿布（カナキン3号）で10往復摩耗する（摩耗时荷重500g）。 ②摩耗処理した面に日東電工(株)製No.31Bテープ（18mm幅）を、5kgのゴムローラーを用いて貼り合わせ、室温で10分間放置する。 ③その後、引張試験機を用いて180°の方向へ300mm/分の速度で剥離し、剥離力を測定する。 ④一方ブランクとして未処理のフィルムについて②～③と同様にして剥離力を測定する。 ⑤下式を用いて耐溶剤磨耗性を算出する。 ●算出式：溶剤処理面の剥離力/未処理面の剥離力 ⑥算出した数値を下記判定基準に準じ判定する。 ●判定基準 ○ 1（変化無し） ○ 1 < x ≤ 5、△ 5 < x < 30 × 30以上（≒シリコンがほぼ完全に脱落）